

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成19年3月15日(2007.3.15)

【公開番号】特開2005-118987(P2005-118987A)

【公開日】平成17年5月12日(2005.5.12)

【年通号数】公開・登録公報2005-018

【出願番号】特願2004-294354(P2004-294354)

【国際特許分類】

B 2 4 D 3/00 (2006.01)

B 2 4 D 5/00 (2006.01)

【F I】

B 2 4 D 3/00 3 1 0 Z

B 2 4 D 5/00 P

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月25日(2007.1.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

支持パッド、ならびにその上に設けられた、繊維で裏打ちされた研磨ディスクを含む研磨システムであり、支持パッドは研磨ディスクの最大半径の95～100%である最大半径を有し、そしてその周囲から間隔をあけて3～6の弦断片が除去され、支持パッドの除去された弦断片領域の最小半径は研磨ディスクの最大半径より20%以下の長さだけ小さい、研磨システム。

【請求項2】

a) ディスクは、ディスクと同心であり、ディスクの半径よりも小さい半径を有する少なくとも1つの円のまわりに間隔をおいた位置のディスク体に3～9の観察開口を持つ、円形の形状を有し；そして

b) 支持パッドは研磨ディスクの半径の95～100%である半径を持つ円形であり、そして3～9の観察開口を有し、支持パッドの周囲から3～6の均等に間隔をおいた弦断片部分が除かれ、ディスクおよび支持パッドが支持パッドの観察開口と配列される研磨ディスクの観察開口とともに配列されるとき、支持パッドの除去された弦断片領域の最小半径は研磨ディスクの最大半径より10～20%の長さだけ小さい、請求項1記載の研磨システム。

【請求項3】

ディスクは使用されるときに回転の目的方向をもつ円形形状を有し、該ディスクはディスクの周囲から除去された3～6の間隔をあけた「オウムのくちばし」の輪郭の部分を有し、除去された各「オウムのくちばし」輪郭部分はディスクの回転の目的方向に関して規定される前および後縁を有し、除去された各「オウムのくちばし」輪郭部分は前および後縁が周囲と出会う点の間の周囲の距離により規定される長さを有し、そしてそこでは除去された各「オウムのくちばし」輪郭部分のディスク体への最深の半径方向侵入は各除去部分の前縁に隣接して生じる、請求項1記載の研磨システム。

【請求項4】

支持パッドの観察開口がディスクの間隔をあけた弦断面除去部分とともに配列されているとき、周囲周りのどの地点でも、支持パッドはディスクの半径寸法よりも大きい半径寸

法を有さないことを条件として、さらには支持パッドの観察開口がディスクの間隔をあけて除去された弦断面部分とともに配列されるとき、ディスクが間隔をあけて除去された弦断面部分を有する周囲の各位置の少なくとも1部内に、間隔をあけて除去された輪郭弦断面部分とともに配列された支持パッドの部分はディスクの半径よりも10~20%短い半径を有することを条件として、支持パッドはディスクの形状と類似した形状を有する、請求項3記載の研磨システム。

【請求項5】

ディスク上の各除去部分の前および後縁が漸近的に名目上の周囲に出会う請求項4記載の研磨システム。

【請求項6】

支持パッドの周囲から除去される部分の数が3である請求項1記載の研磨システム。

【請求項7】

ディスクおよび支持パッドは、システムが使用されるときにレジスターにあり、支持パッドにおいて、周囲から除去された部分の間に、支持パッドの最短半径寸法よりも小さいディスク中心から半径距離で位置される観察開口をそれぞれ備える請求項2記載の研磨システム。

【請求項8】

観察開口および周囲からの除去部分の組合わせ効果が用いられてディスクの最大半径寸法の少なくとも半分により連続的な観察を可能にすることを提供するように観察開口が位置される請求項2記載の研磨システム。

【請求項9】

支持パッドおよびディスクが配列手段を備え、それによりディスクはパッドに搭載され得、それぞれの開口はレジスターにある請求項2記載の研磨システム。

【請求項10】

配列手段は、同一の、非円形、軸上に位置して設ける孔からなる請求項9記載の研磨システム。

【請求項11】

支持パッドは同一の、まっすぐな円の弦の形状で間隔をあいて周囲から除去された部分を有する円形ディスクの形である請求項1記載の研磨システム。